



AUTO EQUIPMENT
SOLUTION PROVIDER

萬潤科技

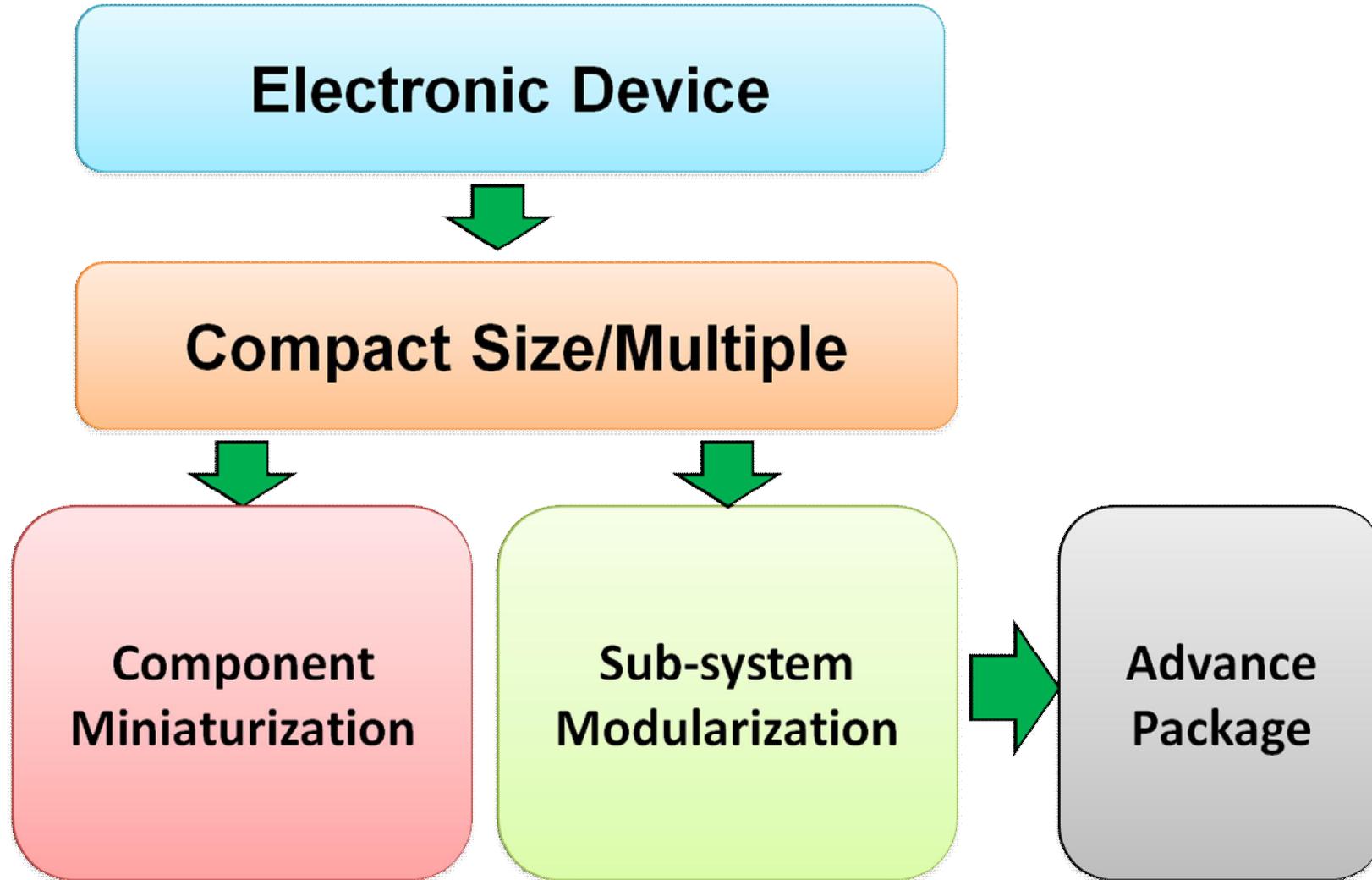
AllRing Tech

Stock Code:6187.TT

公司簡介

成立	1996年5月24日
股本	8.33億
產業	自動化設備
員工	246
董事長	盧鏡來
地址	高雄市路竹區路科十路1號
網站	www.allring-tech.com.tw

產業概況



先進封裝

封裝形式		製造商		運用
積體電路系統封裝	封測廠	ASE		手機 物聯網 車用
		USI		
	模組廠	Hon Hai		
		Luxshare		
	零組件	AAC		
		AMS		
3D封裝	InFO,CoWoS	晶圓廠	TSMC	手機 物聯網 車用
	SoIC		TSMC	
覆晶封裝	2D/2.5D	封測廠	ASE	手機 物聯網 車用
			Spil	
			Amkor	
			Chipbond	
			Powertech	

台積電3D封裝

TSMC 3DFabric™



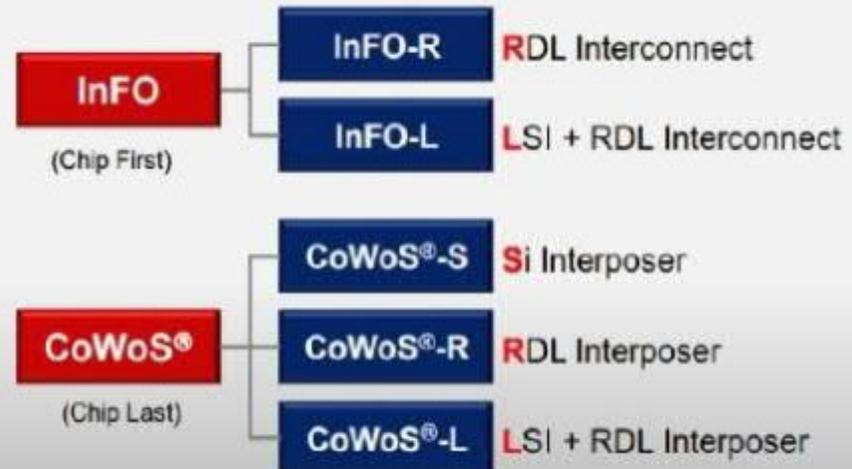
Chip Stacking (FE 3D)



SoIC: System on Integrated Chips

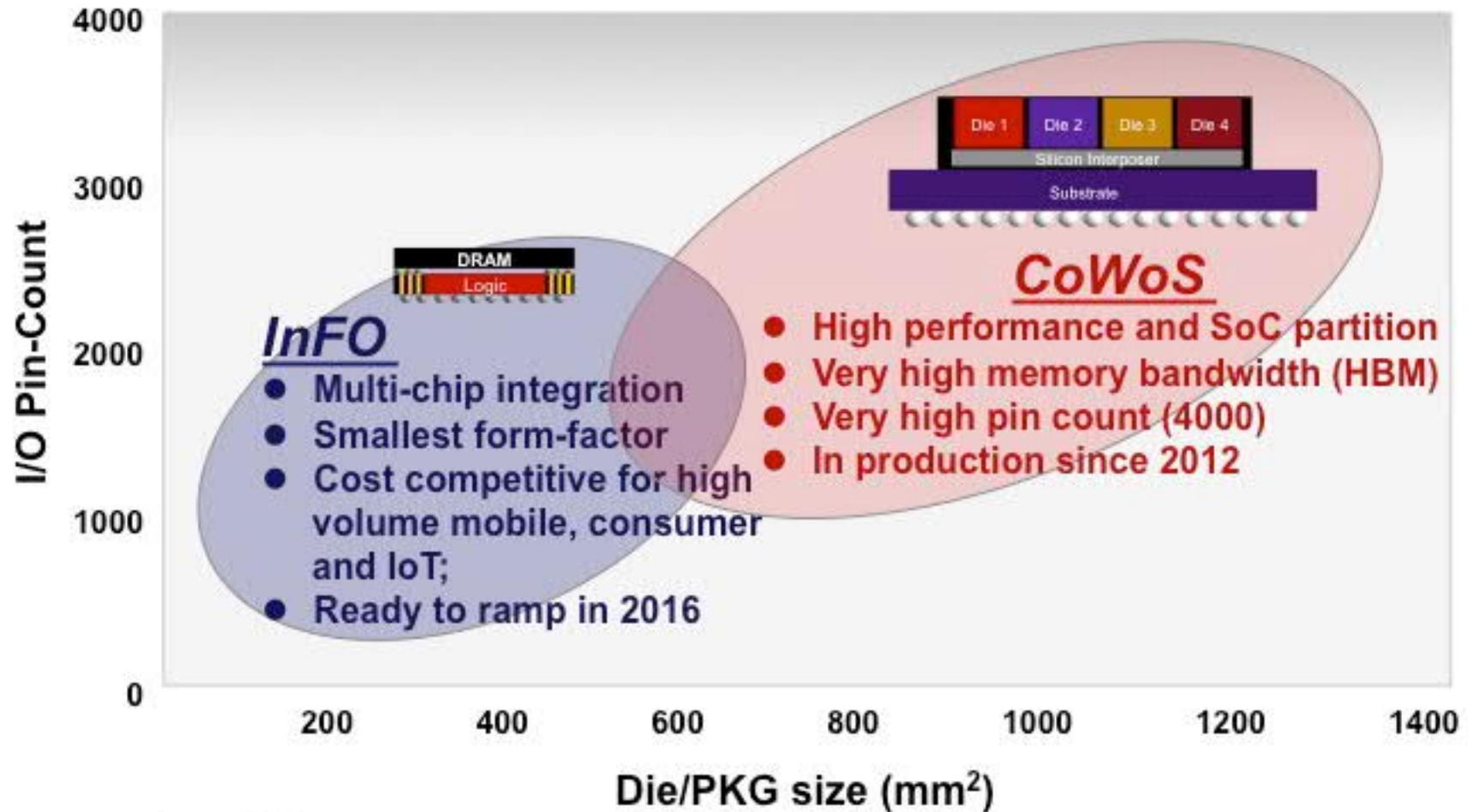
Source: TSMC

Advanced Packaging (BE 3D)

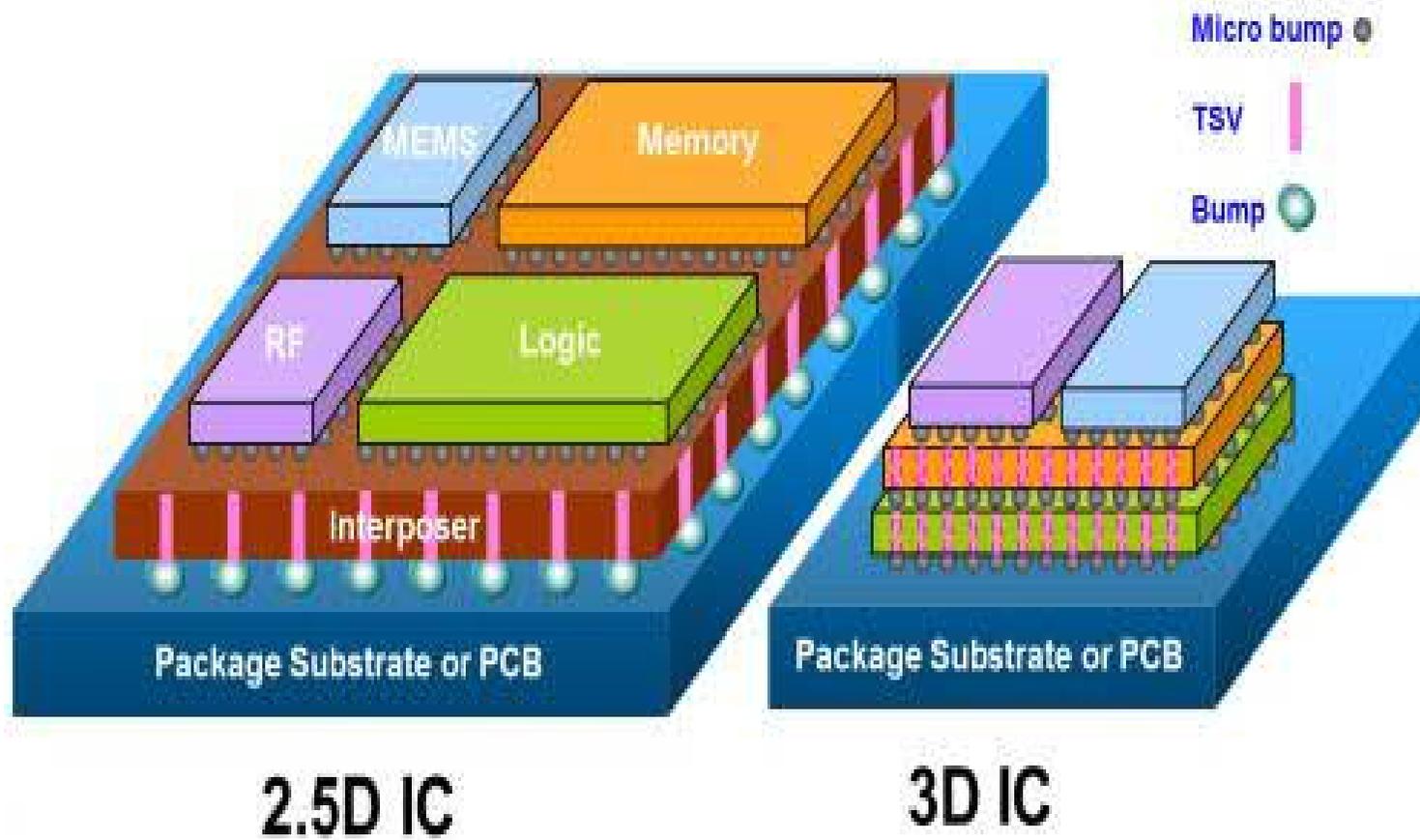


InFO: Integrated Fan-Out
CoWoS: Chip on Wafer on Substrate
RDL: Redistribution Layer
LSI: Local Si Interconnect

台積電 InFO & CoWoS



2.5D & 3D IC 封装

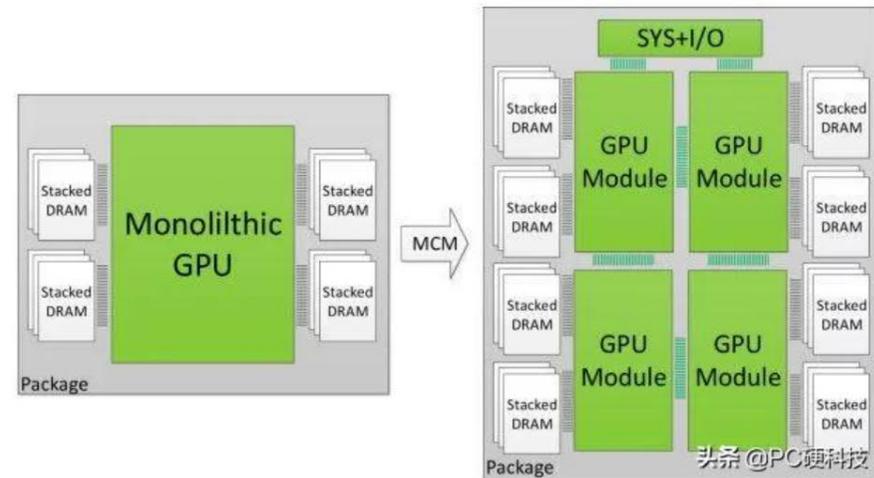


先進封裝

- 先進封裝製程
 - 2D 封裝
 - 覆晶封裝
 - (多晶片模組)
 - 2.5D 封裝
 - COWOS
 - INFO
 - 3D 封裝
 - COWOS
 - INFO

先進封裝

- 先進封裝製程
 - 2D 封裝
 - 覆晶封裝
 - (多晶片模組)
 - 2.5D 封裝
 - COWOS
 - INFO
 - 3D 封裝
 - COWOS
 - INFO

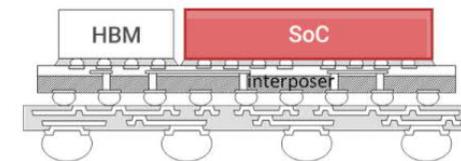


先進封裝

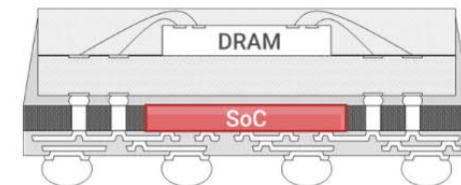
- 先進封裝製程
 - 2D 封裝
 - 覆晶封裝
 - (多晶片模組)
 - 2.5D 封裝
 - COWOS
 - INFO
 - 3D 封裝
 - COWOS
 - INFO



CoWoS®



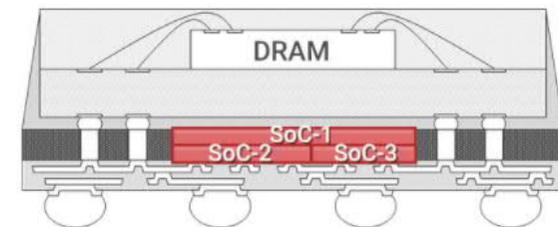
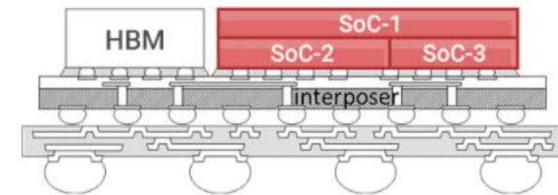
InFO_PoP



先進封裝

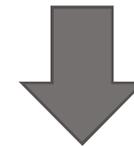
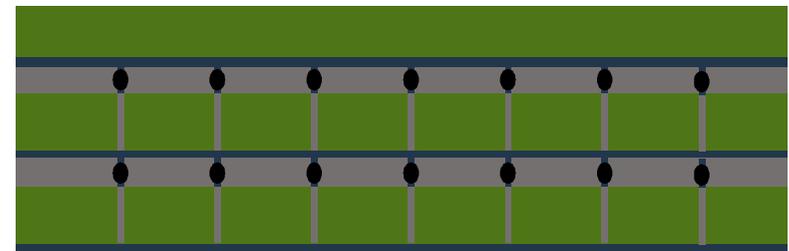
- 先進封裝製程
 - 2D 封裝
 - 覆晶封裝
 - (多晶片模組)
 - 2.5D 封裝
 - COWOS
 - INFO
 - 3D 封裝
 - COWOS
 - INFO

SOIC

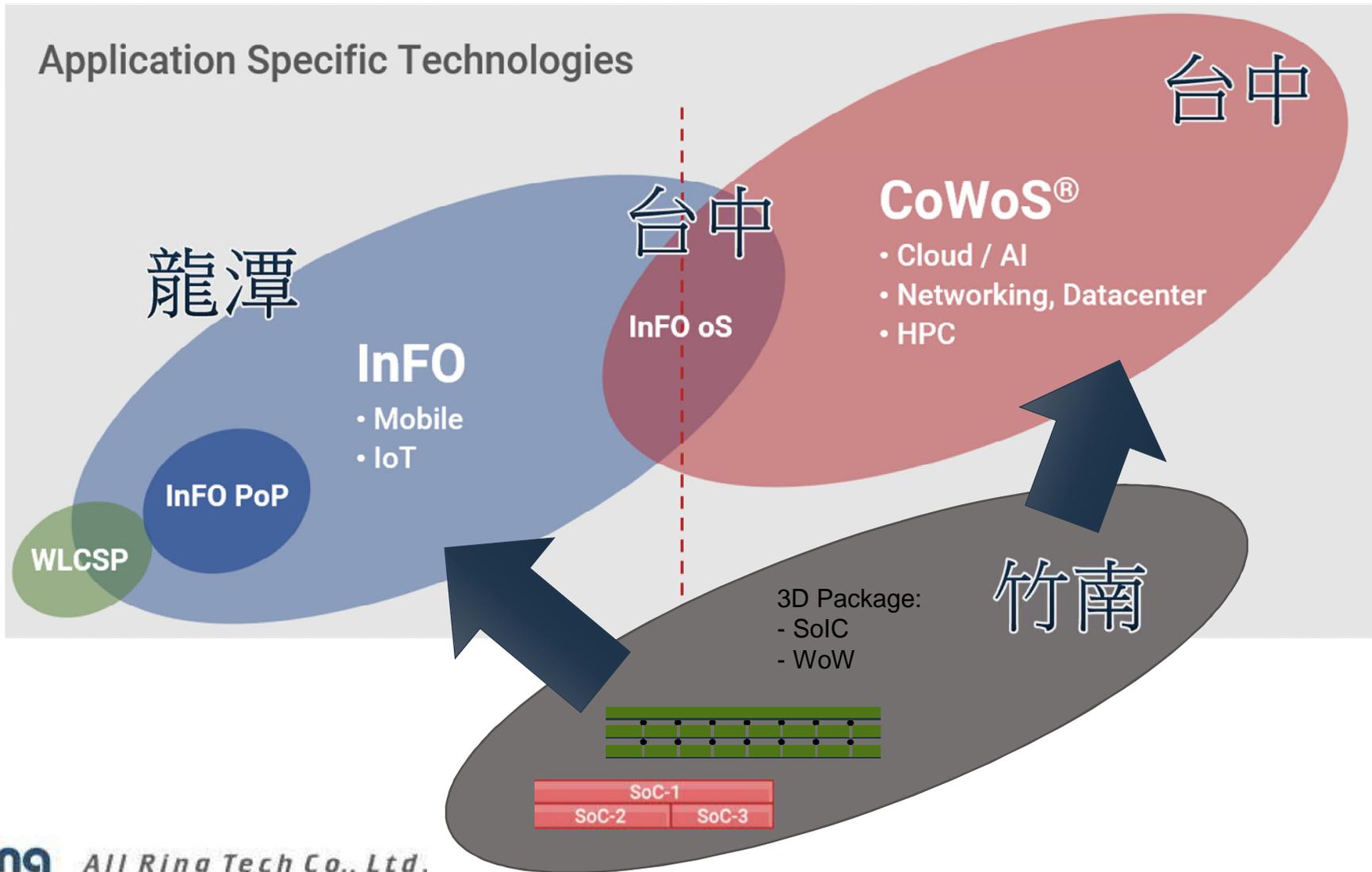


先進封裝

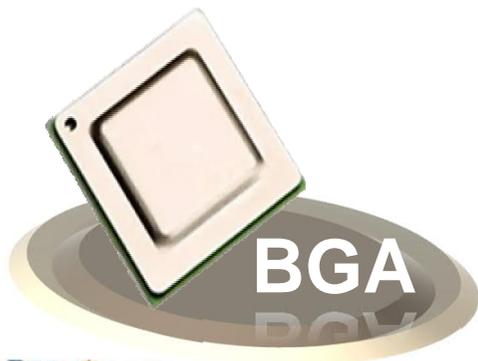
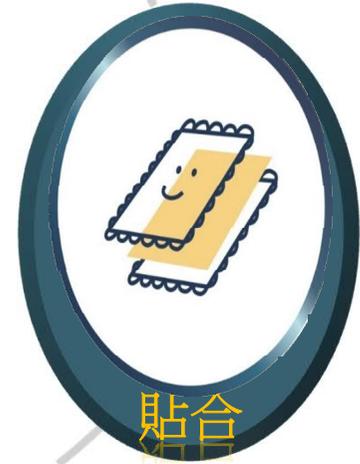
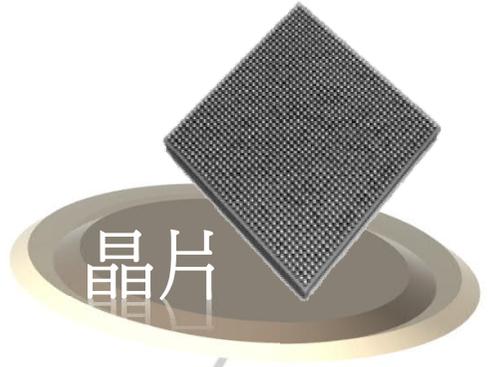
- 先進封裝製程
 - 2D 封裝
 - 覆晶封裝
 - (多晶片模組)
 - 2.5D 封裝
 - COWOS
 - INFO
 - 3D 封裝
 - COWOS
 - INFO



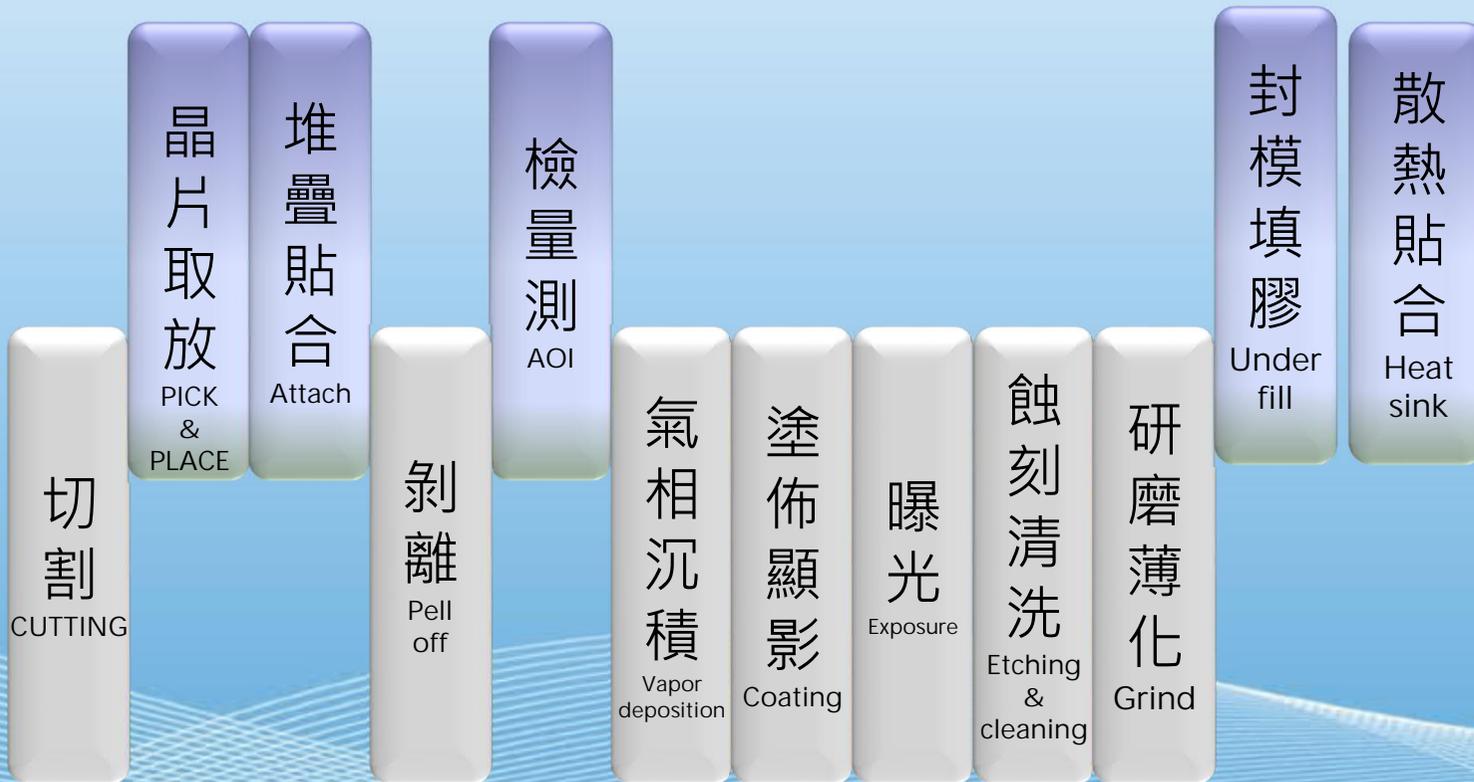
台積電 3D 封裝



核心技术



萬潤機台



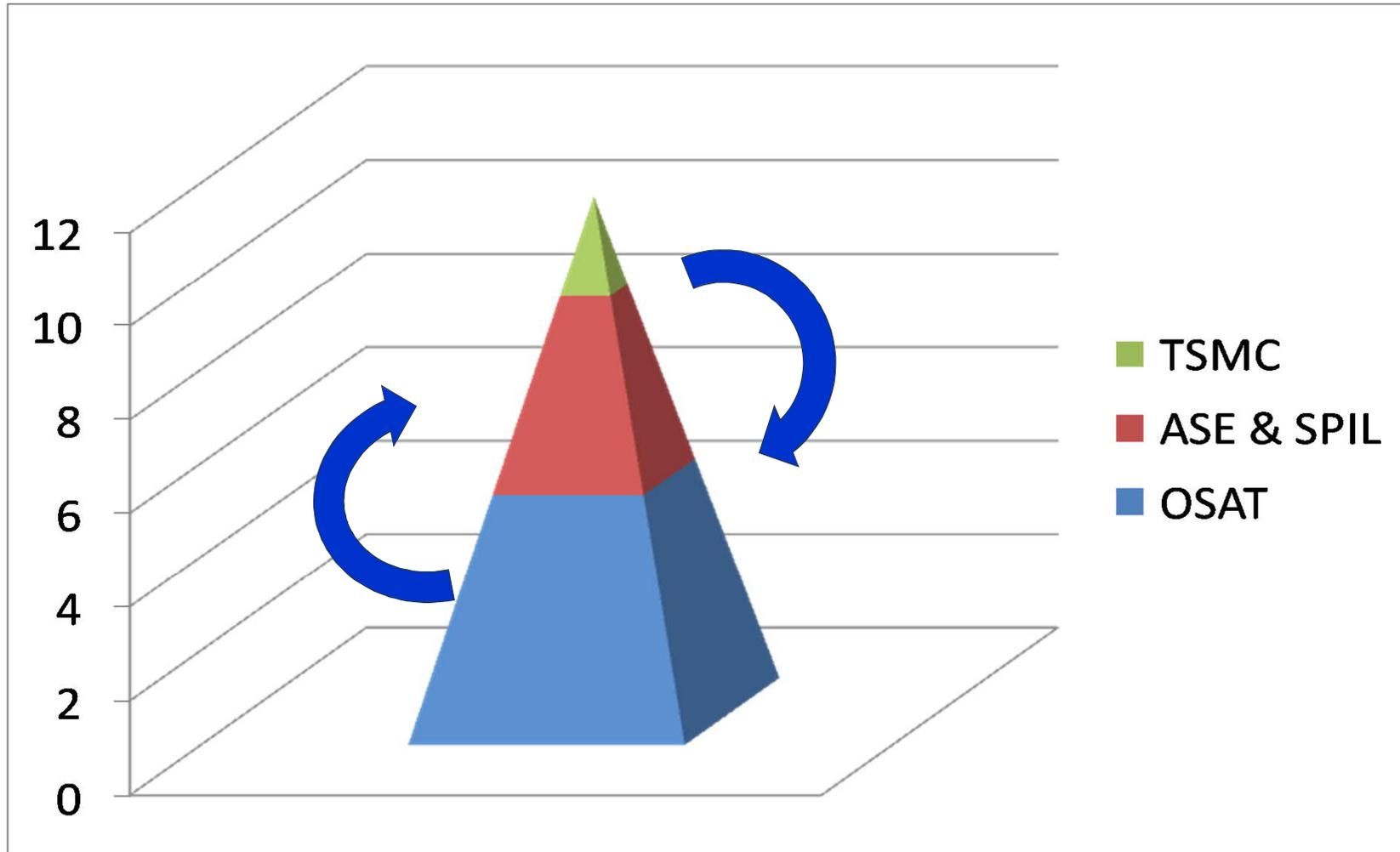


萬潤的角色

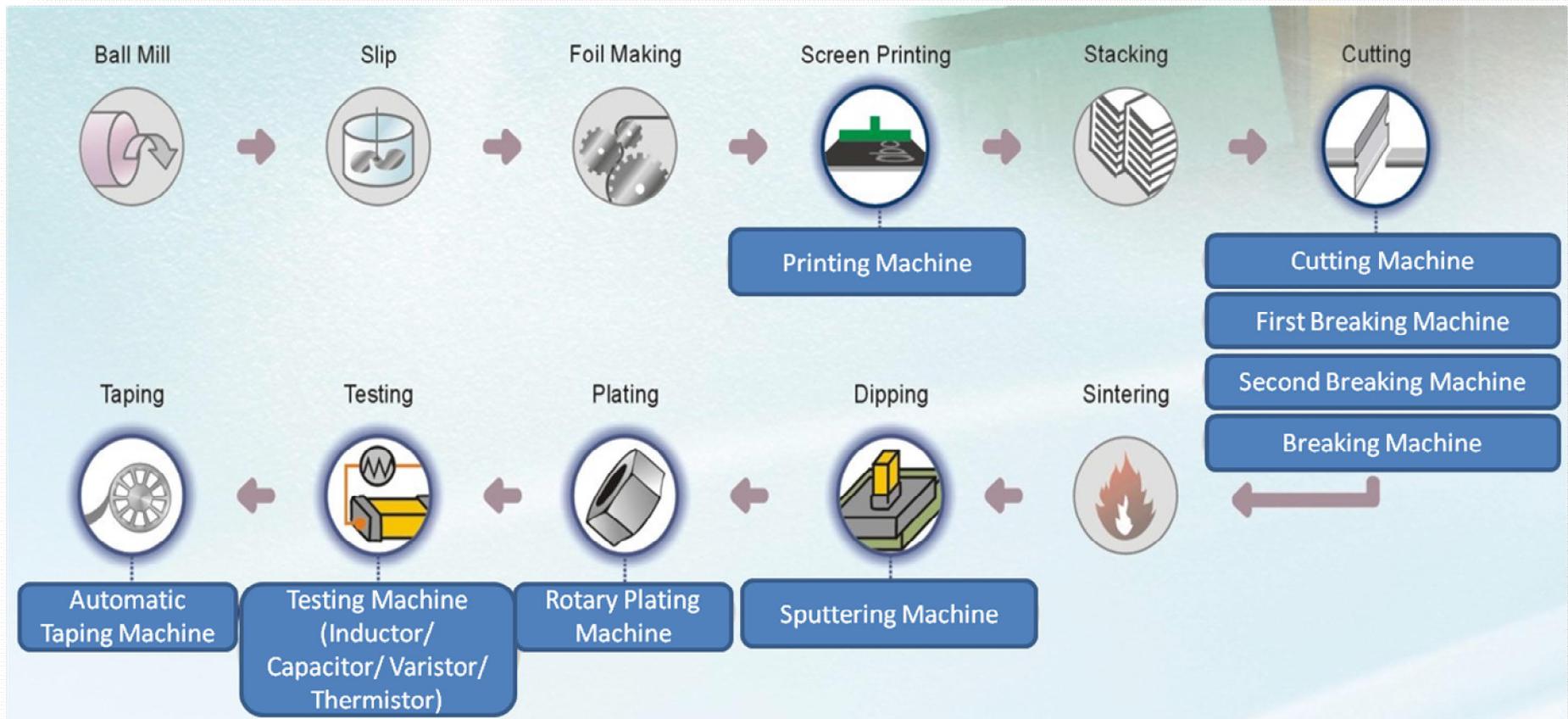
- 高階封裝整合製程
 - 新製程發展
 - 高效率機台

- 無人化工廠
 - 重工
 - 檢查
 - 自動化傳輸
 - 無故障
 - 客戶服務

公司目標



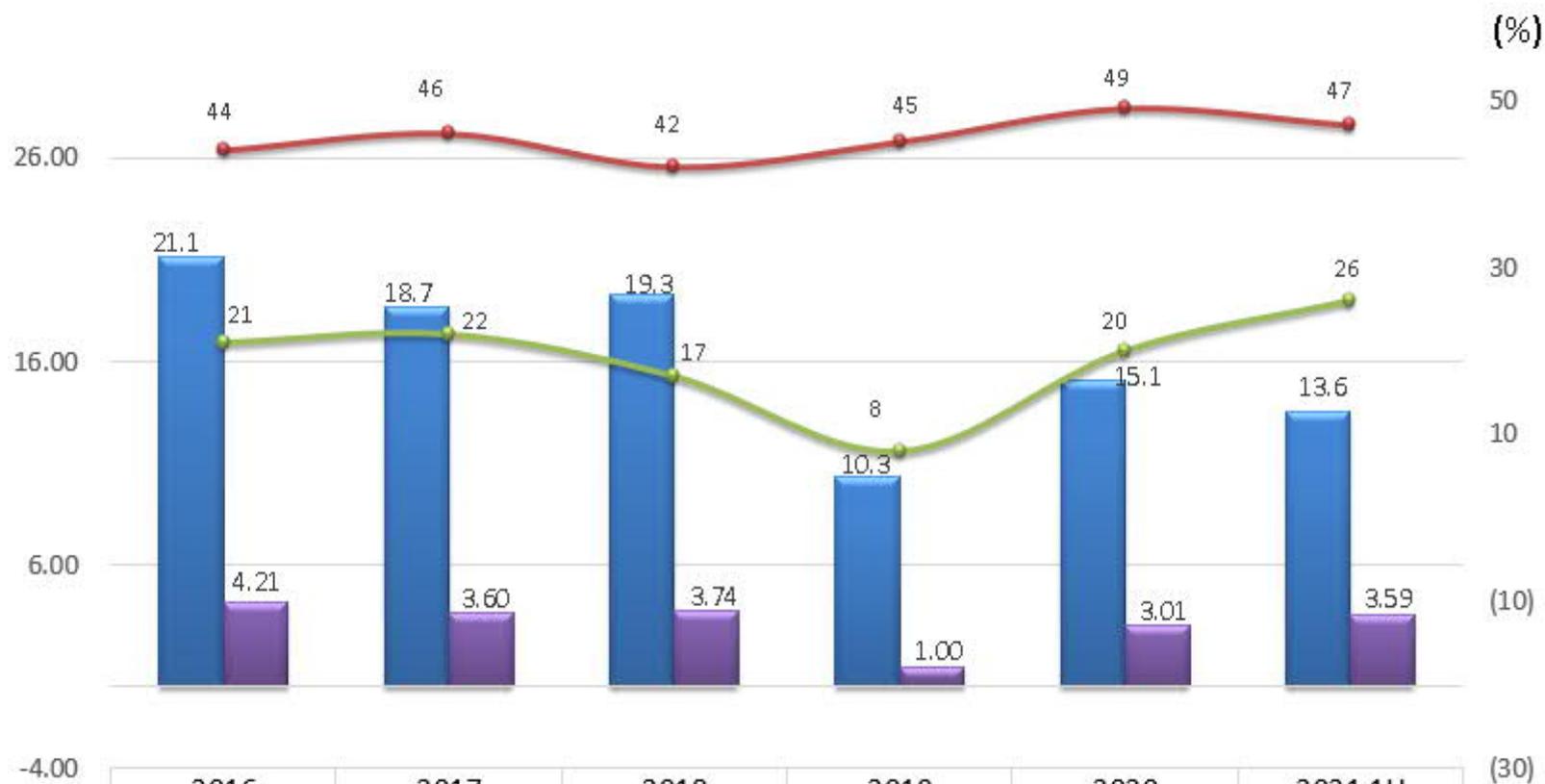
被動元件生產流程圖



客戶

Semiconductor	Passive Component
    	
   	
   	
   	
	   

財務資訊

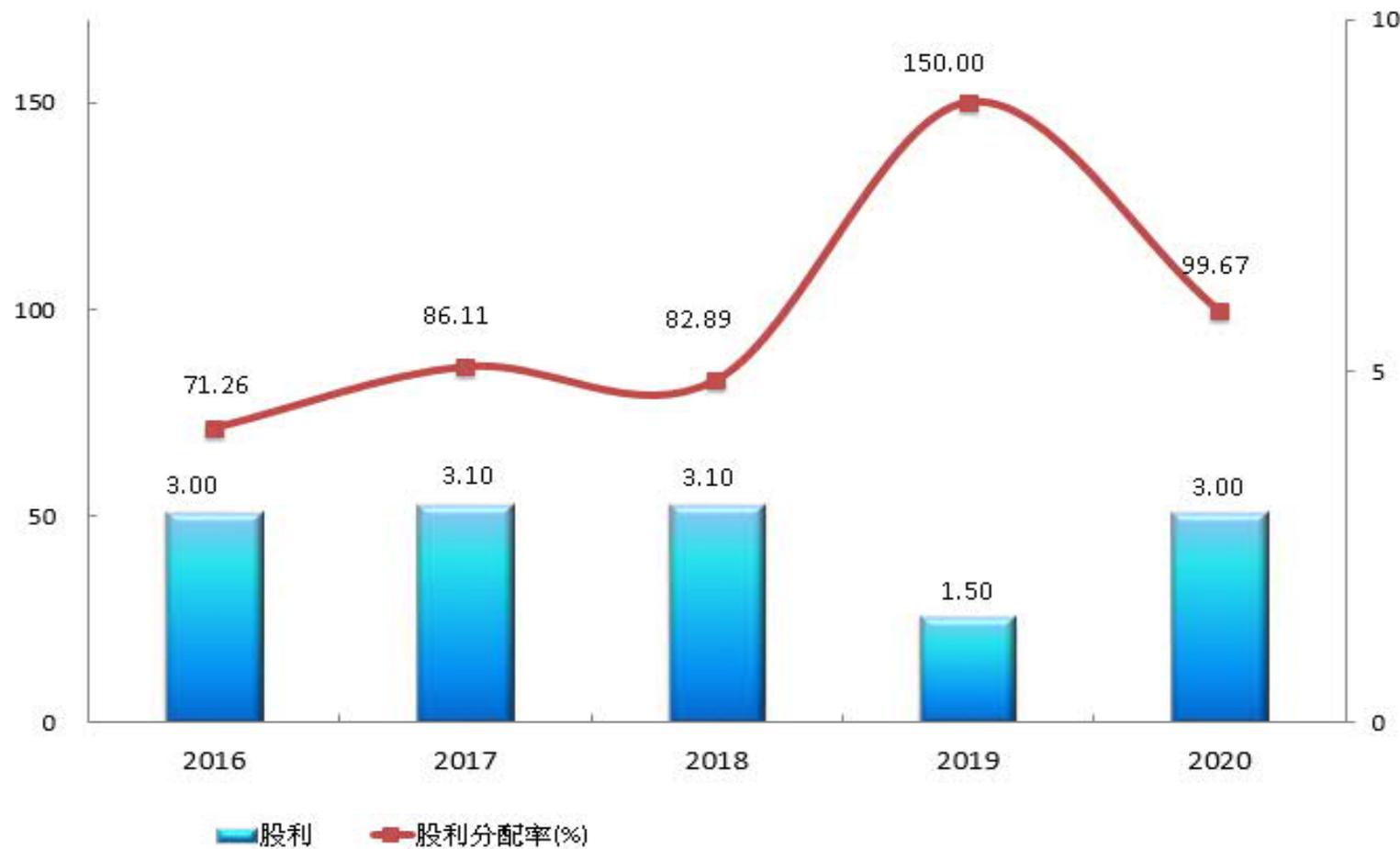


	2016	2017	2018	2019	2020	2021.1H
營收(NT\$100mn)	21.1	18.7	19.3	10.3	15.1	13.6
每股盈餘(NT\$)	4.21	3.60	3.74	1.00	3.01	3.59
毛利(%)	44	46	42	45	49	47
營業利益(%)	21	22	17	8	20	26

財務資訊

(%)

(新台幣 元)





Q & A



李建德

Tel:+886-7-6071828



lee@allring-tech.com.tw